

SY6000 存储器测试系统

SY6000 是一款通用、高性能的内存测试系统。该多功能测试系统可以对高速、大容量器件进行晶圆测试和封装测试，如 DRAM、NAND 和 MCP（多芯片封装）等芯片。

SY6000 可以以较高的测试速率对存储芯片进行测试，并确保高定时精度、高重复性和出色的故障检测能力。其测试速率最高可达 2.4Gbps（DDR 模式），定时精度高达 $\pm 100\text{ps}$ 。SY6000 最大配置可达 4096 个数字测试通道，最大支持 496 个器件同步测试，从而大幅降低测试成本。

SY6000 系统是兼具成本效益的大批量存储器测试解决方案，能够对 DRAM 和 NAND 闪存器件进行晶圆分选测试和后道封装测试。在移动电子产品销售激增的情况下，DRAM、NAND 闪存和多芯片封装（MCP）（智能手机和平板电脑中使用的主要芯片）的发展趋势正迅速向更高速和更大芯片容量转型。这个趋势同样显见于互联网和云端服务器市场。然而，对于芯片制造商而言，测试现有各类存储器的成本是一大障碍；迫切需要能够提供多功能、高性能和低测试成本（COT）的解决方案。速跃芯仪的新型多功能 SY6000 存储器测试系统可以全部满足这些需求，包括 DDR4、高速 NAND 闪存和新一代非易失性存储器。

主要特性

1. 适用于下一代移动 DRAM 和 NVM 的完整测试能力；
2. AFM 支持实时错误捕获；
3. 可扩展的高性能 MRA；
4. 实时 DQS 与 DQ 功能可提高产量并消除培训；
5. 每站点测试架结构减少了测试时间；
6. 数据生成和捕获存储器 UBM、DBM、DFM 等故障捕获。



主要功能指标

项目	规格
最大测试率	2.4Gbps
并行测试能力	DDR4 (x8) 内存: 496DUT; NAND 闪存: 448DUT
覆盖范围	全面覆盖 DDR3/DDR4 到 NAND 闪存测试

系统灵活性

1. 涵盖所有测试需求、工程、晶圆排序和最终测试；
2. 相同的软件和测试程序语言；
3. 相同的测试电子设备系统平台。

系统平台

软件平台

SYtest 为 SY6000 系统的测试工程开发软件平台，开发人员可在该平台上完成测试工程的发展、调试，实现集成电路的测试和测试数据的获取。

SYtest 主要包含工程开发编辑和向量编辑调试两部分，可实现：测试工程开发、测试参数验证、测试结果读取和保存。

硬件平台

系统机台

型号	SY6000STH	SY6000MTH	SY6000LTH
槽位	5 槽	10 槽	20 槽
尺寸	长 × 宽 × 高： 650×765×960mm	长 × 宽 × 高： 910×765×960mm	-
电源	220VAC/50Hz, 3kW	220VAC/50Hz, 6kW	-
工作温度	20-25°C	20-25°C	20-25°C
储存温度	-10~+50°C	-10~+50°C	-
保修	一年	一年	一年

标配（机）件

设备	配置要求
操控计算机	运行内存：8GB 以上；硬盘：240G 以上；操作系统：Windows10 以上
水冷机	SY2001